
IBM Power System S812LC (8335-GTB) - Guide d'installation rapide

Lisez l'ensemble des recommandations et instructions avant de commencer à utiliser le système et ses composants.

Appliquez les procédures de décharge électrostatique standard avant d'intervenir sur le système et ses composants. IBM recommande le port de gants et d'un bracelet antistatique contre les décharges électrostatiques afin d'éviter d'endommager le matériel.

Les informations relatives au système 8335-GTB sont disponibles en ligne dans l'IBM Knowledge Center. <https://ibm.biz/QR8335-GCB>

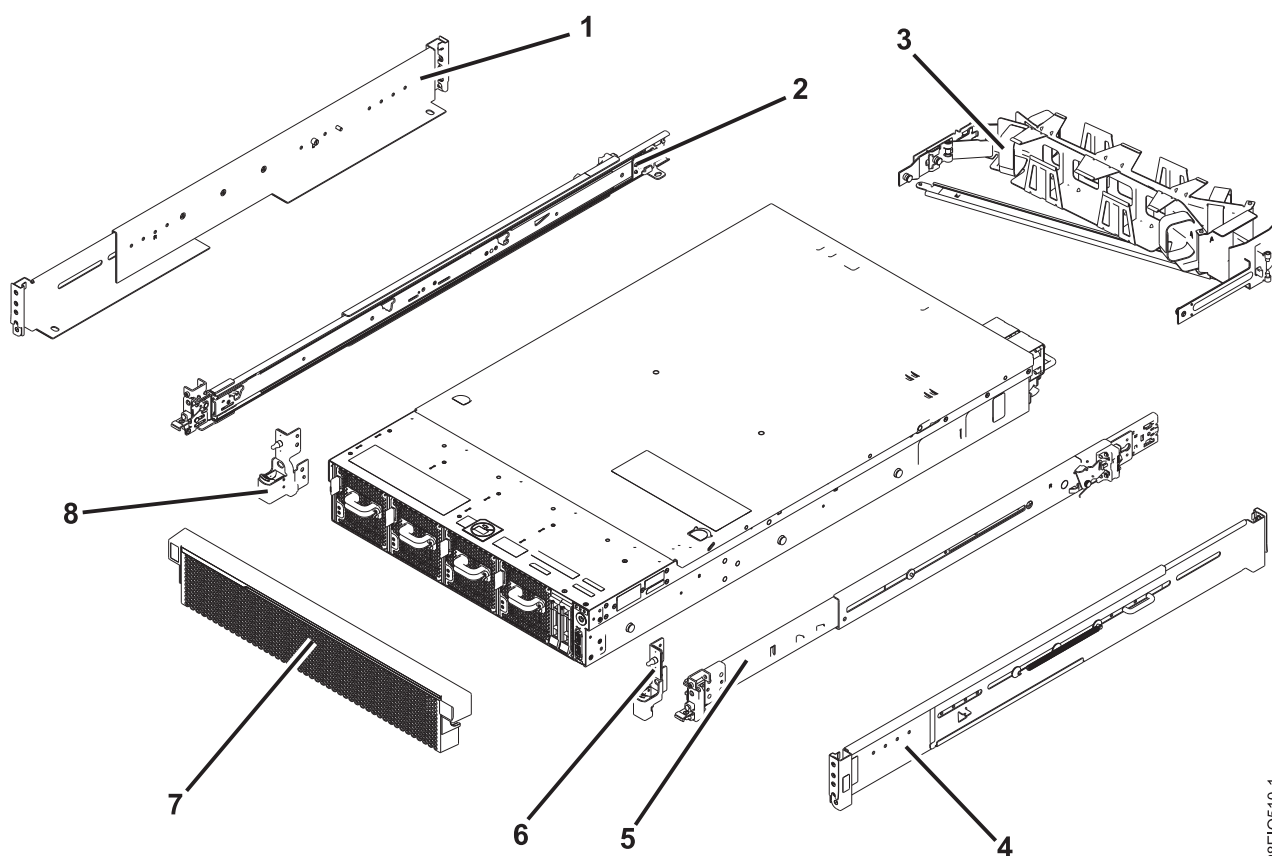


Composants des systèmes 8335-GTB

Utilisez ces informations pour rechercher la référence de l'unité remplaçable sur site.

Après avoir identifié le numéro de référence de la pièce que vous souhaitez commander, allez à la page Advanced Part Exchange Warranty Service. Vous devez vous enregistrer. Si vous ne parvenez pas à identifier le numéro de référence, allez à la section Contacter le service de maintenance et de support IBM®.

Assemblage final en armoire



P8EIO510-1

Figure 1. Assemblage final en armoire

Tableau 1. Références d'assemblage final en armoire

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
1	45W8836	1	Kit de glissières fixe : contient les glissières fixes gauche et droite ainsi que les vis de fixation
2	00E4260	1	Kit de glissières : contient les glissières gauche et droite ainsi que les vis de fixation
3	74Y9063	1	Assemblage du bras de routage des câbles
4	45W8836	1	Kit de glissières fixe : contient les glissières fixes gauche et droite ainsi que les vis de fixation
5	00E4260	1	Kit de glissières : contient les glissières gauche et droite ainsi que les vis de fixation
6		1	Support EIA (Electronic Industries Association) (côté droit)
7	00E4688	1	Panneau
8		1	Support EIA (côté gauche)

Composants système (systèmes à refroidissement par air et par eau)

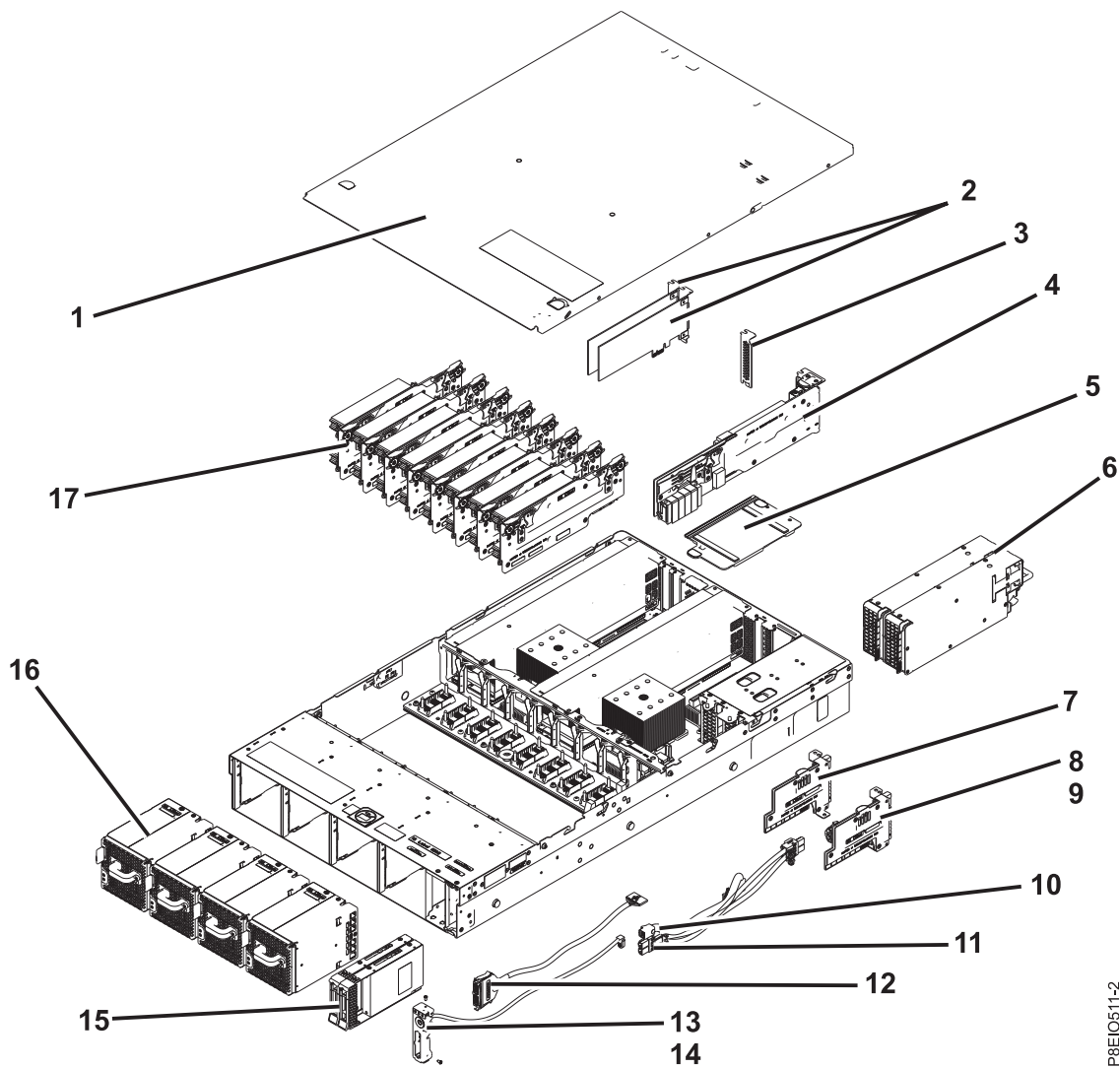


Figure 2. Composants système (systèmes à refroidissement par air et par eau)

Tableau 2. Composants système (systèmes à refroidissement par air et par eau)

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
1		1	Assemblage du capot d'accès supérieur
2		2 à 3	Cartes PCI. Utilisez le type de fonction de la carte pour rechercher le numéro FRU dans les cartes PCIe des systèmes 8335-GTB.
3	46K5109	1 à 2	Obturateur PCI
4	00E4574	1	Carte de contrôleur de gestion de la carte mère (BMC)
5		1	Défecteur d'air du connecteur de bus d'alimentation
6	01AF370	2	Alimentation électrique
7	00E4705	1	Connecteur de bus d'alimentation sans emplacement de batterie de l'horloge

Tableau 2. Composants système (systèmes à refroidissement par air et par eau) (suite)

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
8	00E4704	1	Connecteur de bus d'alimentation avec emplacement de la batterie de l'horloge Remarque : La référence du connecteur de bus d'alimentation n'inclut pas la batterie de l'horloge. La batterie de l'horloge est une pile au lithium CR2450N.
9		1	Batterie de l'horloge
10	00E4482	1	Câble d'interface des ventilateurs et des disques
11	00E4481	1	Câble d'alimentation des ventilateurs
12	00E4550	1	Câble USB avant avec connecteur
13	00E5189	1	Interrupteur d'alimentation et câble
14		2	Vis
15	00E4252	2	Obturateur d'unité
	00LY266	2	Unité de disque de 1 To
	00LY418	2	Unité de disque de 2 To
	00LY409	2	Unité SSD de 480 Go
	00LY411	2	Unité SSD de 960 Go
	00LY423	2	Unité SSD SATA de 1,9 To
	00LY438	2	Unité SSD de 3,84 To
16	00E4256	4	Ventilateur
17	00E4251	8	Obturateur de carte de bus mémoire
	00E4498	8	Carte de bus mémoire
	78P4618	32	RDIMM DDR4 4 Go, 1600 MHz
	78P4620	32	RDIMM DDR4 8 Go, 1600 MHz
	78P4621	32	RDIMM DDR4 16 Go, 1600 MHz
	78P4622	32	RDIMM DDR4 32 Go, 1600 MHz

Composants système additionnels (système à refroidissement par air)

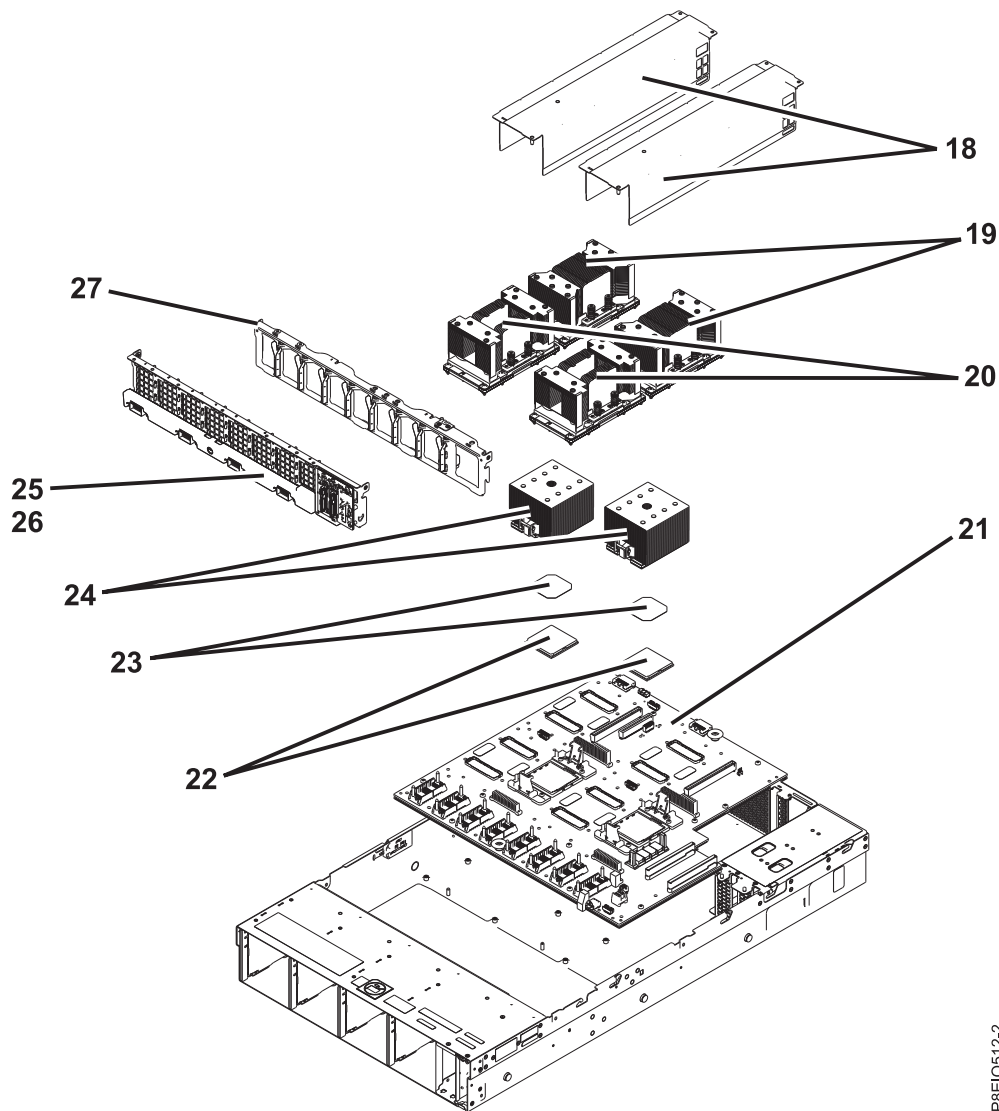


Figure 3. Composants système additionnels (système à refroidissement par air)

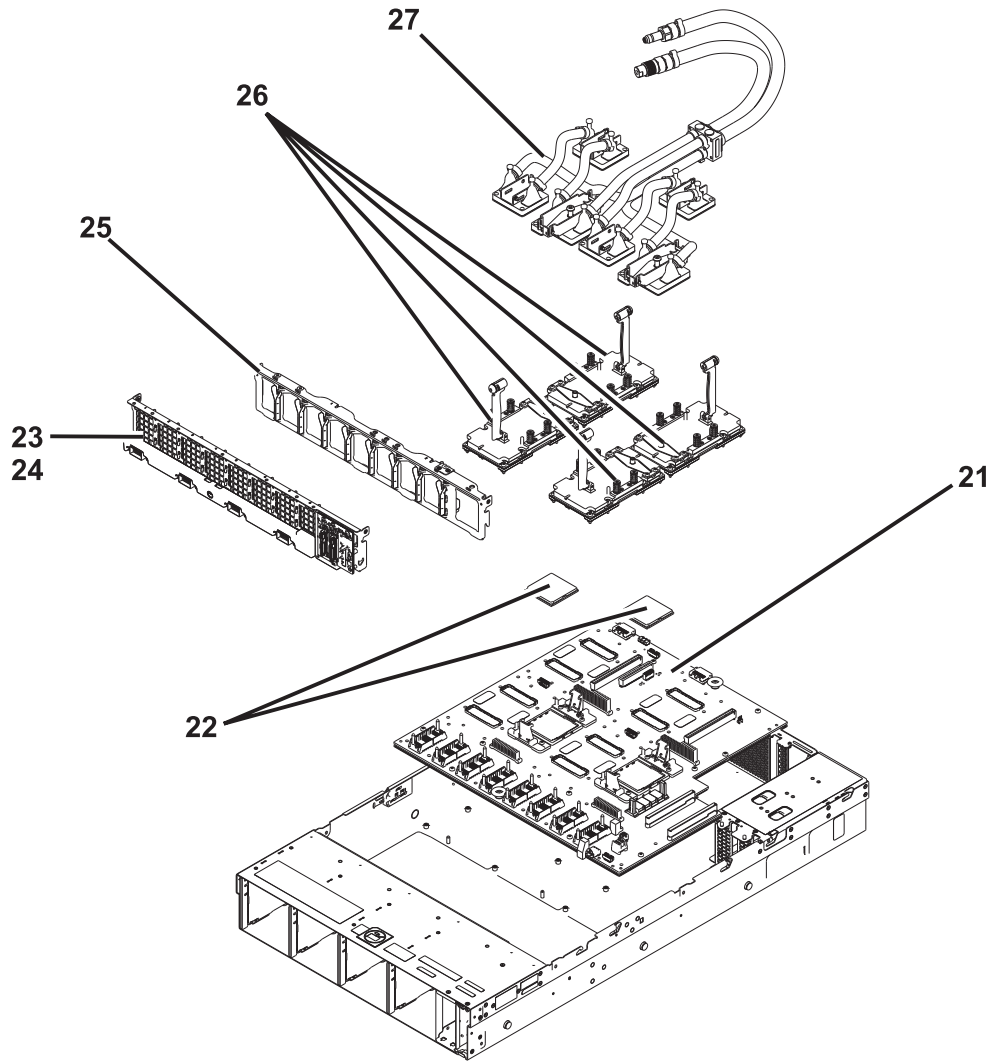
Tableau 3. Composants système additionnels (système à refroidissement par air)

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
18		2	Déflecteurs d'air des processeurs graphiques
19	01EM024	2	Kit GPU arrière (inclut la carte GPU, le déflecteur d'air, le dissipateur thermique et le matériau d'interface thermique)
20	01EM025	2	Kit GPU avant (inclut la carte GPU, le déflecteur d'air, le dissipateur thermique et le matériau d'interface thermique)
21	00E4570	1	Kit de fond de panier système (inclut l'outil de retrait des modules, une clé hexagonale de 4 mm, un tournevis magnétique, une pompe à air et l'outil de retrait du couvercle)

Tableau 3. Composants système additionnels (système à refroidissement par air) (suite)

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
22	00E5185	2	Kit de module de processeur système 8 coeurs 3,259 GHz (inclut le module de processeur système, le bac processeur, un tournevis hexagonal de 4 mm, l'outil de remplacement du module et une pompe à air)
	00E5187	2	Kit de module de processeur système 10 coeurs 2,860 GHz (inclut le module de processeur système, le bac processeur, un tournevis hexagonal de 4 mm, l'outil de remplacement du module et une pompe à air)
23	01AF227	2	Kit de dissipateur thermique du processeur système (inclut le dissipateur thermique et le TIM)
24	01AF227	2	Kit de dissipateur thermique du processeur système (inclut le dissipateur thermique et le TIM)
25	00E5128	1	Carte des ventilateurs et des unités de disque
26	00E4476	1	Kit de vis Remarque : Le kit de vis inclut 12 vis pour la carte des ventilateurs et des unités de disque et 16 vis pour le fond de panier du système.
27		1	Support central du fond de panier système

Composants systèmes additionnels (système à refroidissement par eau)



P8EIO513-1

Figure 4. Composants systèmes additionnels (système à refroidissement par eau)

Tableau 4. Composants systèmes additionnels (système à refroidissement par eau)

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
21	00E4570	1	<p>Kit de fond de panier système (inclut l'outil de retrait des modules, une clé hexagonale de 4 mm, un tournevis magnétique, une pompe à air et l'outil de retrait du couvercle)</p> <p>Remarque : Lorsque vous remplacez le kit de fond de panier système dans un système 8335-GTB à refroidissement par eau, vous avez également besoin du kit de remplacement du TIM du processeur système (01EM029) et du kit de fond de panier système à refroidissement par eau (01EM030). Le kit de fond de panier système à refroidissement par eau (01EM030) n'est pas requis si vous l'avez déjà.</p>

Tableau 4. Composants systèmes additionnels (système à refroidissement par eau) (suite)

Numéro d'index	Référence	Unités par assemblage	Description
22	00E5185	2	Kit de module de processeur système 8 coeurs 3,259 GHz (inclut le module de processeur système, le bac processeur, un tournevis hexagonal de 4 mm, l'outil de remplacement du module et une pompe à air)
	00E5187	2	Kit de module de processeur système 10 coeurs 2,860 GHz (inclut le module de processeur système, le bac processeur, un tournevis hexagonal de 4 mm, l'outil de remplacement du module et une pompe à air)
23	00E5128	1	Carte des ventilateurs et des unités de disque
24	00E4476	1	Kit de vis Remarque : Le kit de vis inclut 12 vis pour la carte des ventilateurs et des unités de disque et 16 vis pour le fond de panier du système.
25		1	Support central du fond de panier système
26	01EM027		Kit GPU à refroidissement par eau (inclut l'ensemble diffuseur, la carte GPU, le déflecteur d'air, le dissipateur thermique et le matériau d'interface thermique)
27	01AF969	1	Ensemble plaques froides (inclut les plaques froides, des pinces brucelles et des matériaux d'interface thermique)

Composants divers

Tableau 5. Composants système divers

Description	Référence	Unités par assemblage
Kit de remplacement du matériau d'interface thermique (inclut un outil de retrait de l'ancien matériau, des pinces brucelles et un matériau d'interface thermique neuf)	01EM029	1
Kit fond de panier système pour système à refroidissement par eau (inclut une plaque froide et un plateau module)	01EM030	1

Ports arrière

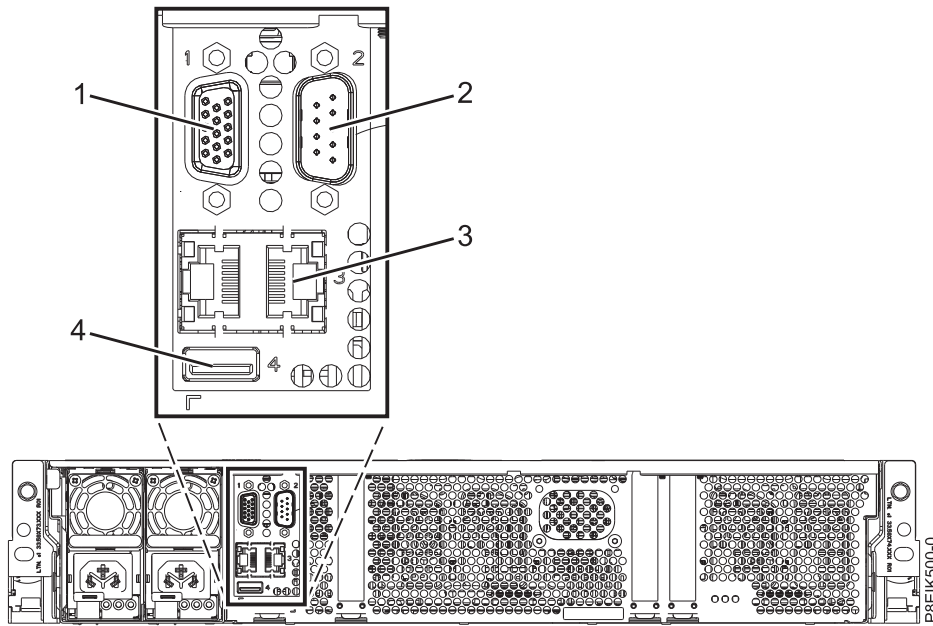


Figure 5. Vue arrière du système avec les ports indiqués

Tableau 6. Description des ports

Identificateur	Description
1	Carte VGA. Seule une capacité texte est offerte pour l'instant.
2	Port série IPMI (Intelligent Platform Management Interface)
3	Ethernet. Utilisez le port Ethernet gauche pour l'interface BMC/IPMI (en tant que eth0). Utilisez le port Ethernet droit pour tout autre usage en lien direct avec le système d'exploitation (en tant que eth1).
4	USB 3.0

Installation et retrait des composants IBM Power System S812LC (8335-GTB)

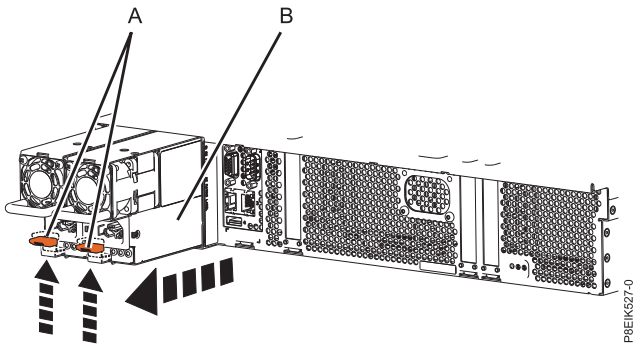


Figure 6. Retrait d'un bloc d'alimentation du système

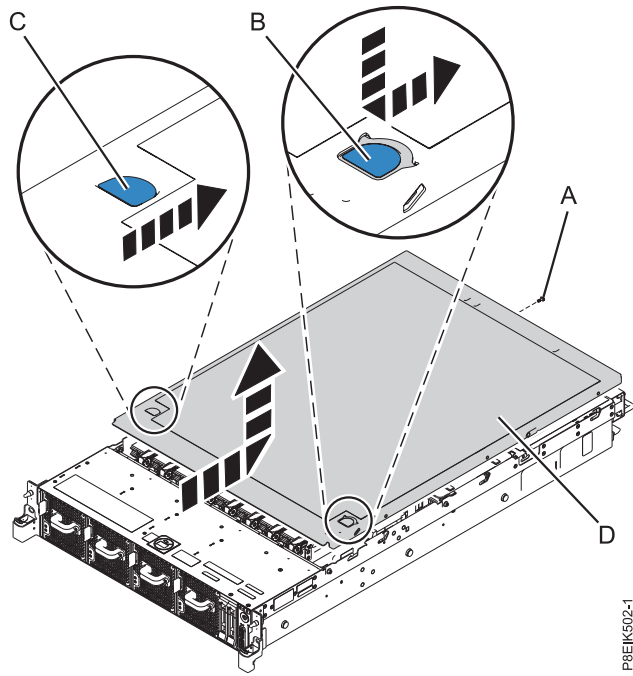


Figure 7. Retrait du capot

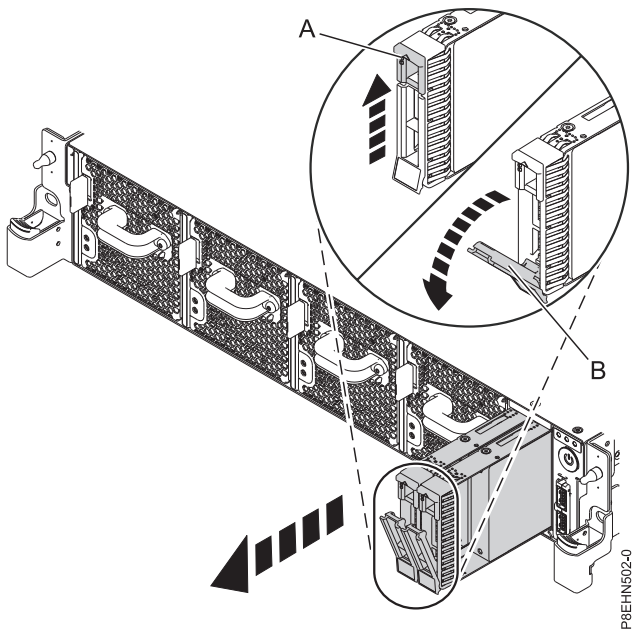


Figure 8. Détails relatifs à la fixation d'une unité de disque

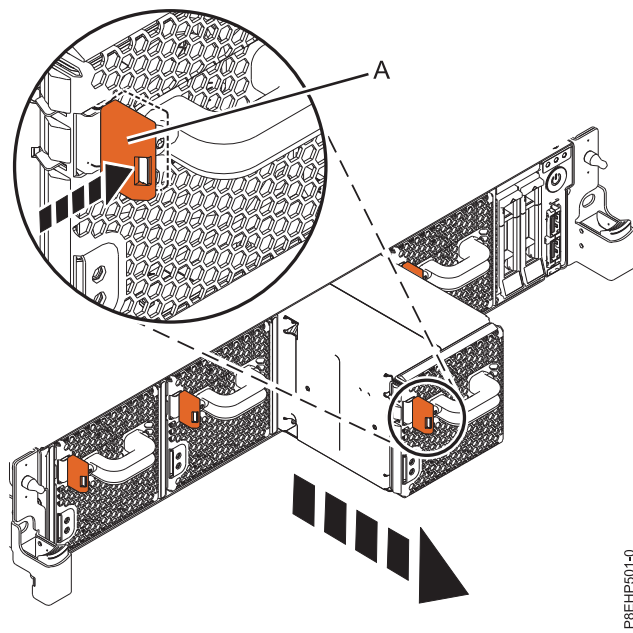


Figure 9. Retrait d'un ventilateur du système

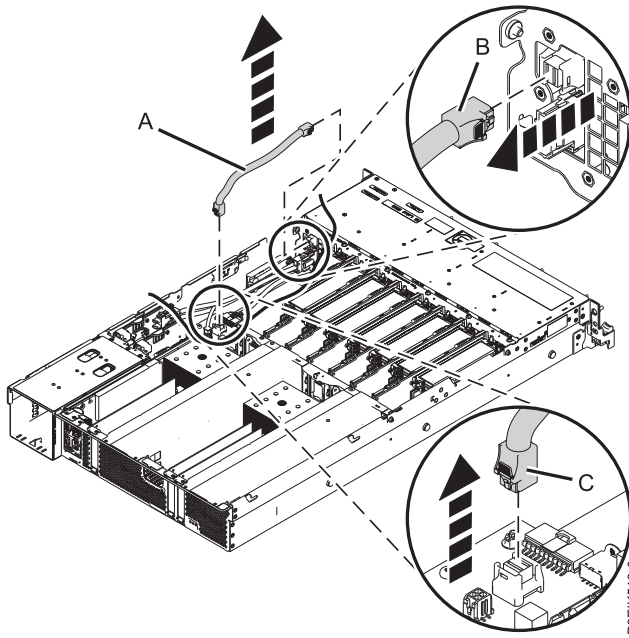


Figure 10. Retrait du câble d'interface des ventilateurs et des disques

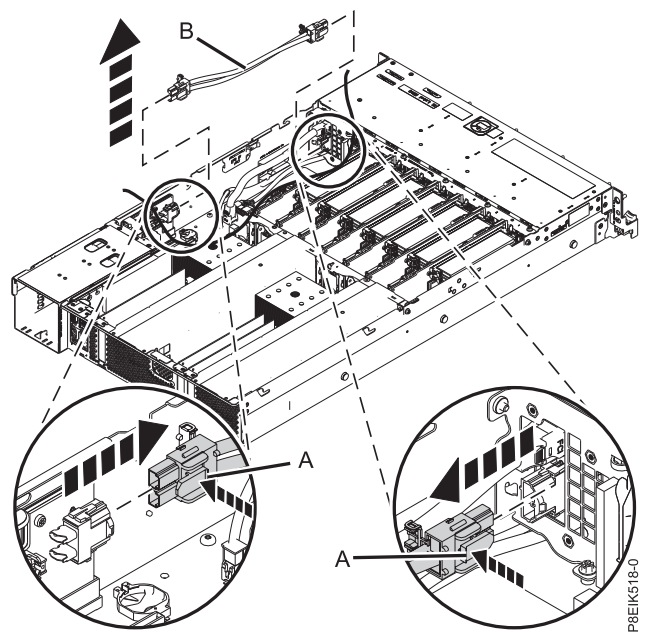


Figure 11. Retrait du câble d'alimentation des ventilateurs du système

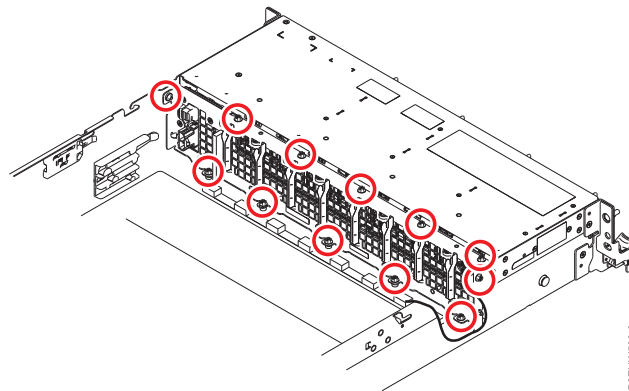


Figure 12. Emplacement des vis de la carte des ventilateurs et des unités de disque

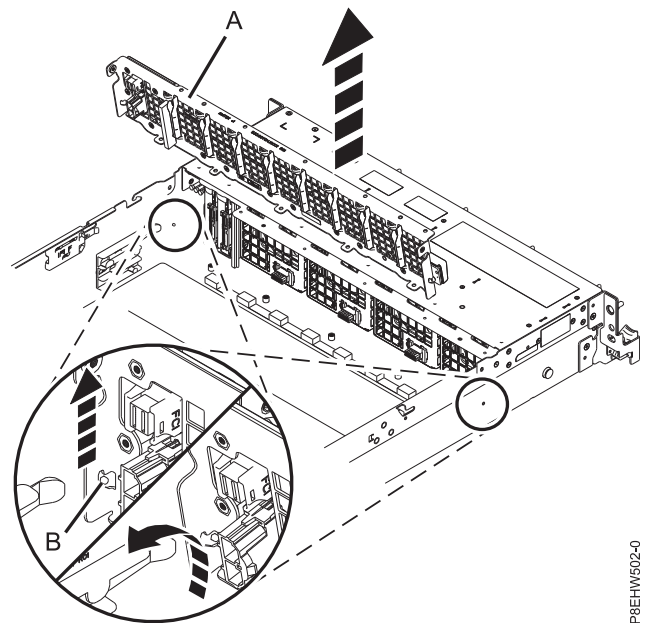
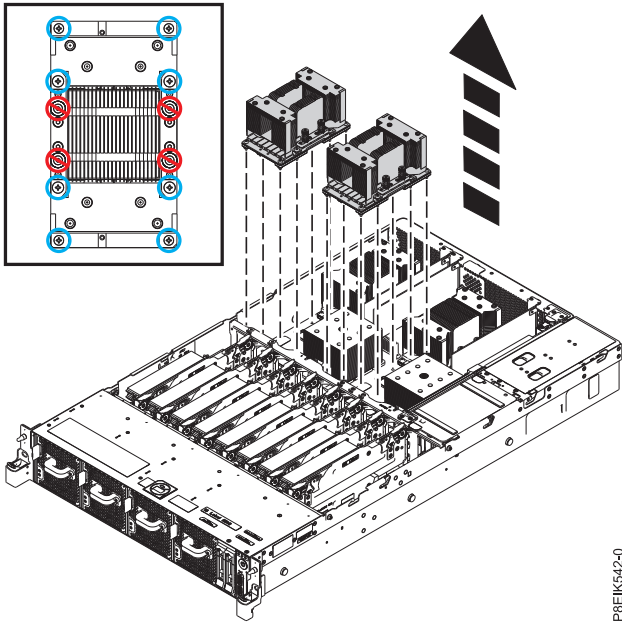
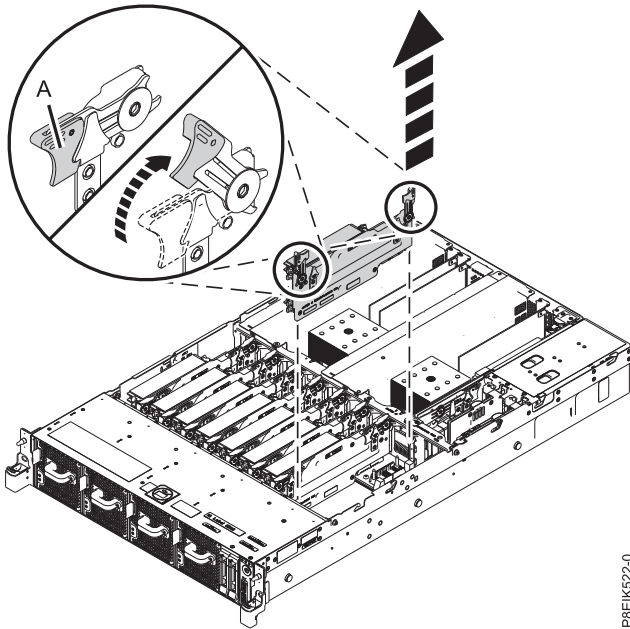


Figure 13. Retrait de la carte des ventilateurs et des unités de disque



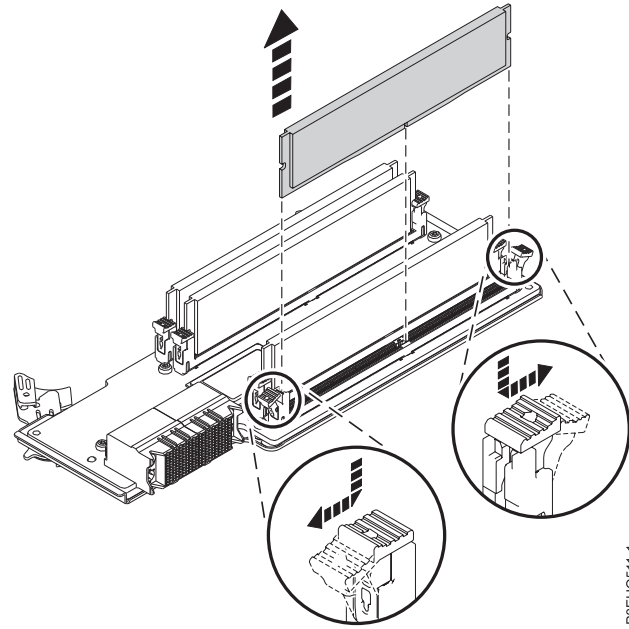
P8EIK542-0

Figure 14. Retrait des huit vis de chaque GPU ; ne pas desserrer les quatre vis à ressort



P8EIK522-0

Figure 15. Retrait d'une carte de bus mémoire du système



P8EHC511-1

Figure 16. Retrait d'une barrette mémoire DIMM d'un emplacement sur la carte de bus mémoire

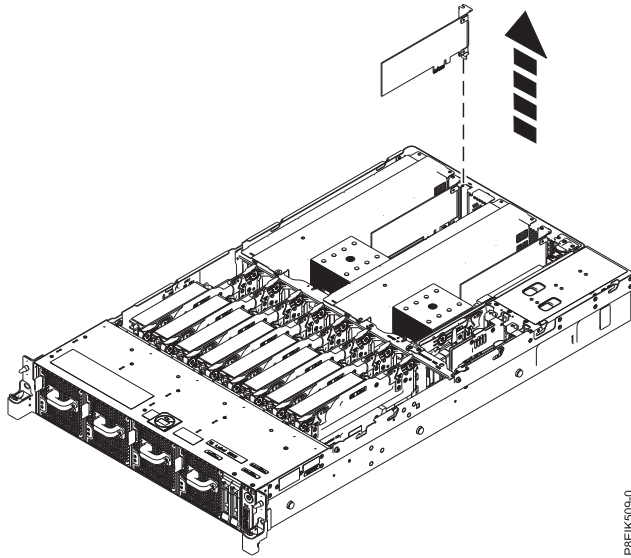


Figure 17. Retrait d'une carte PCIe

P8EIK509-0

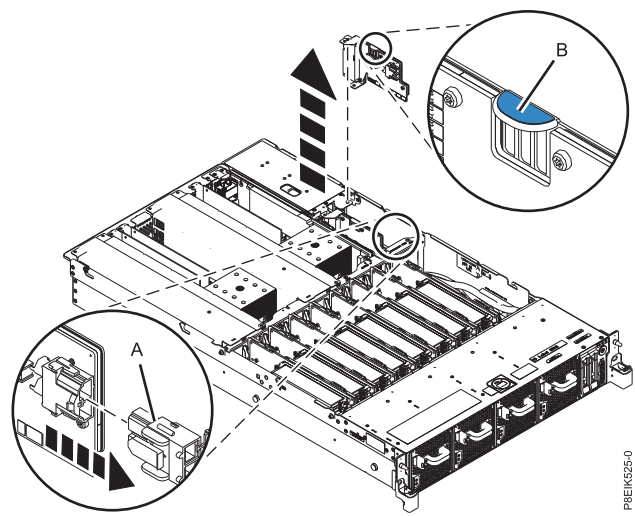


Figure 18. Retrait d'un connecteur de bus d'alimentation du système

P8EIK525-0

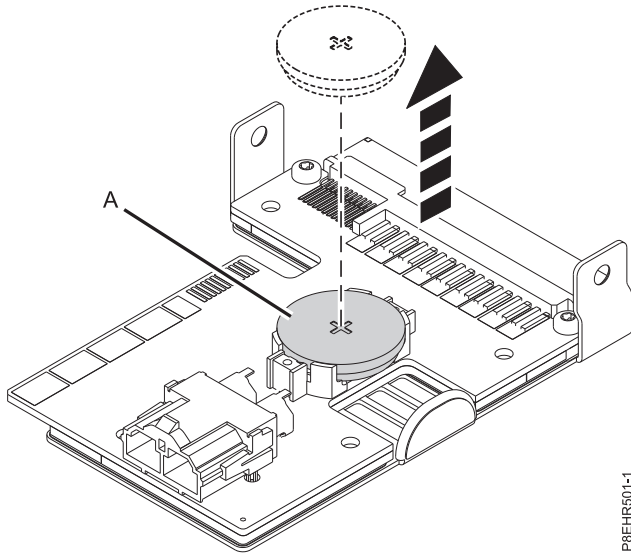


Figure 19. Retrait de la batterie de l'horloge du connecteur de bus d'alimentation

P8EHR501-1

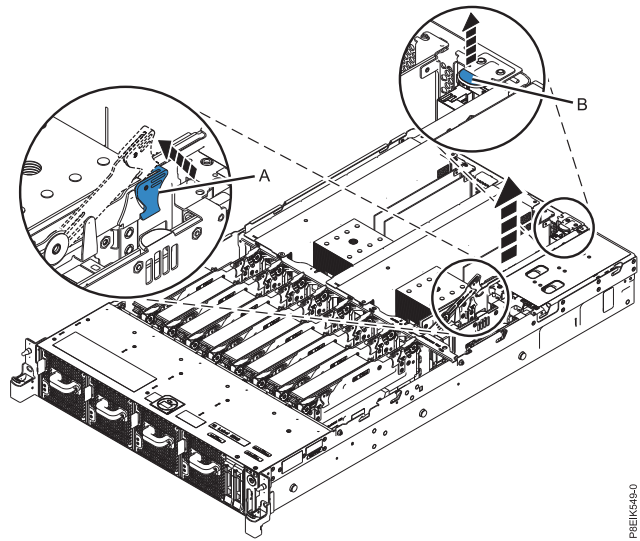


Figure 20. Retrait de la carte BMC

P8EIK548-0

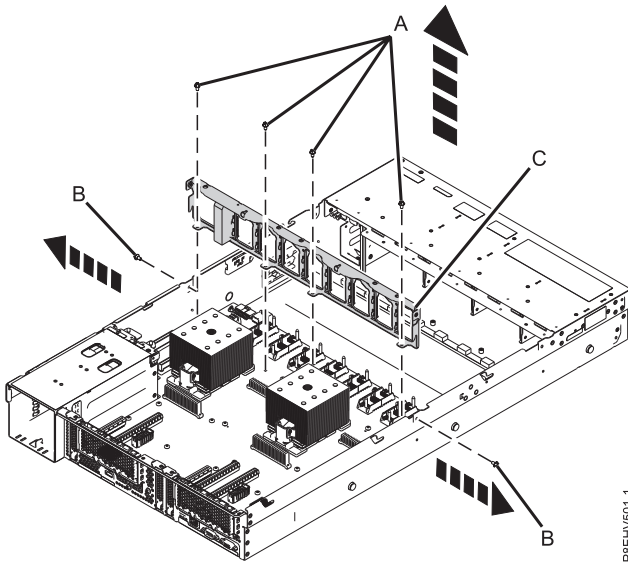
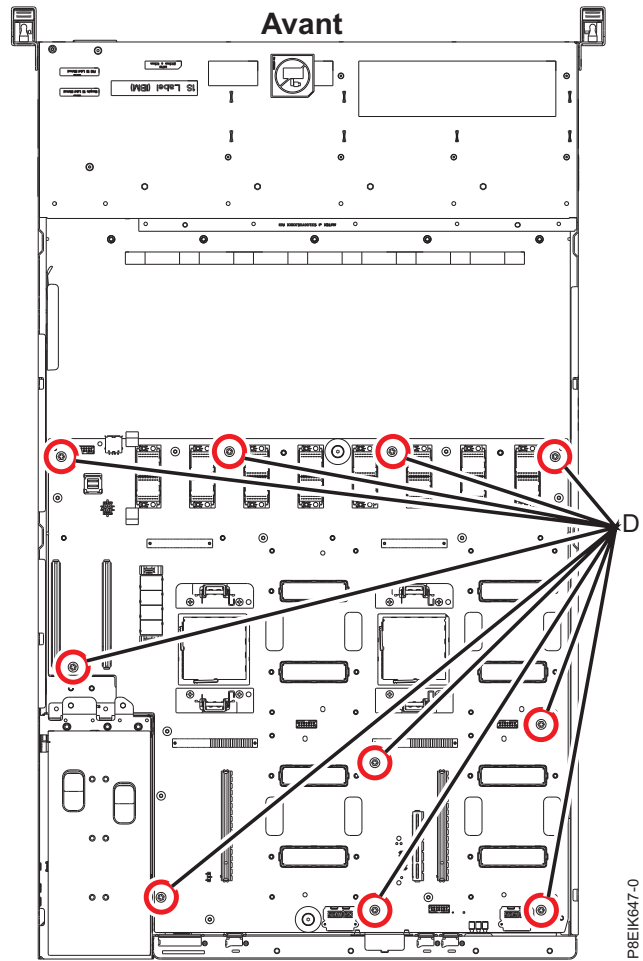


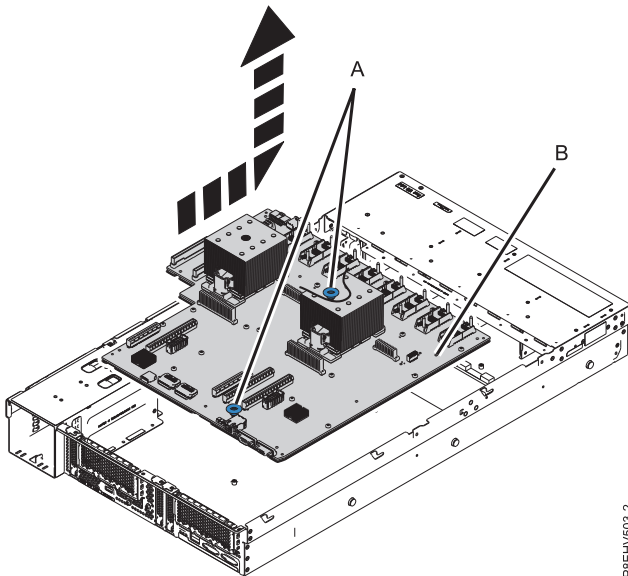
Figure 21. Retrait du support du milieu et emplacement des vis

P8EHV501-1



P8EIKG47-0

Figure 22. Emplacement des vis du fond de panier système



P8EHV503-2

Figure 23. Extraction du fond de panier système

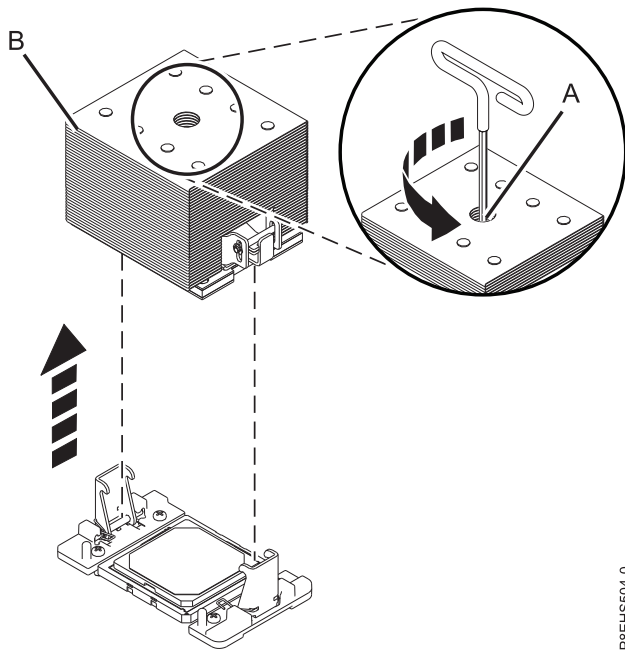


Figure 24. Retrait du dissipateur thermique

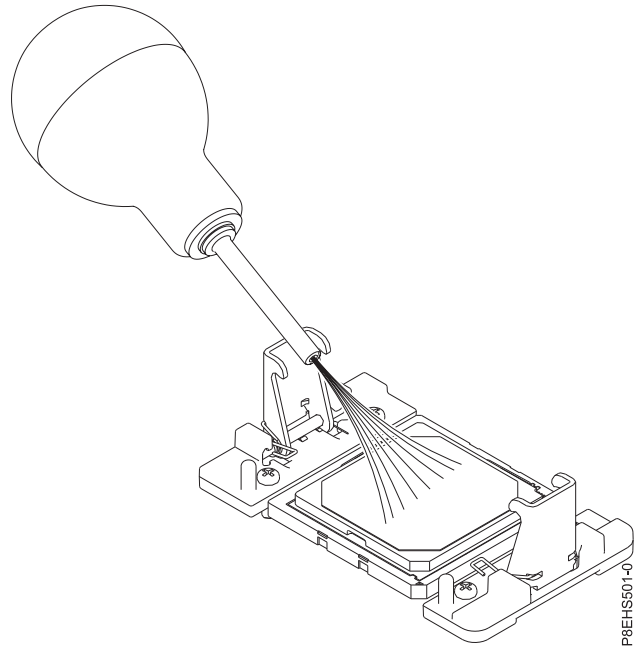


Figure 25. Retrait de la poussière et des particules présentes sur le module processeur système

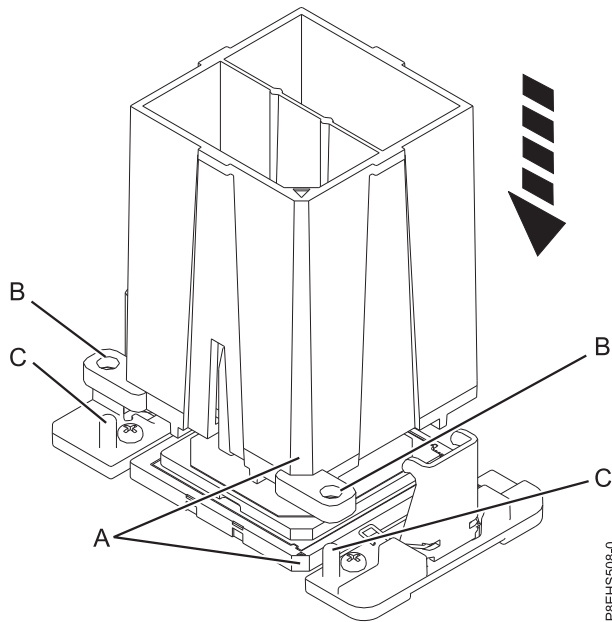


Figure 26. Abaissement de l'outil de retrait sur le module processeur système

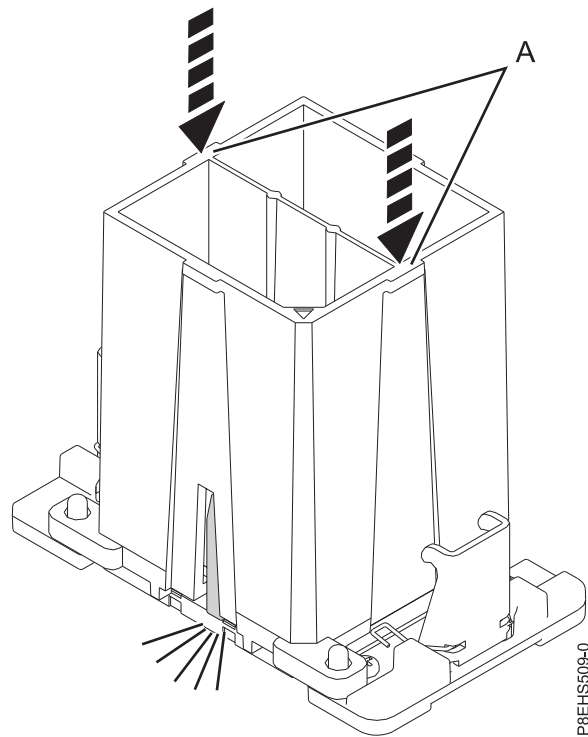
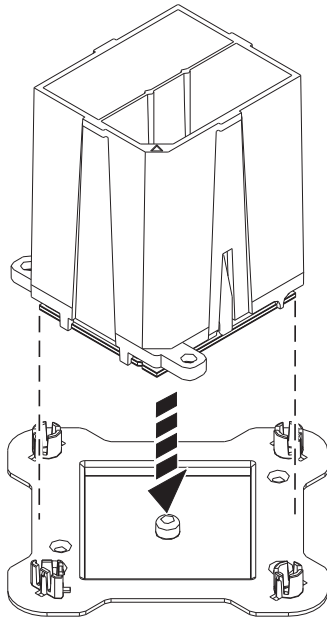
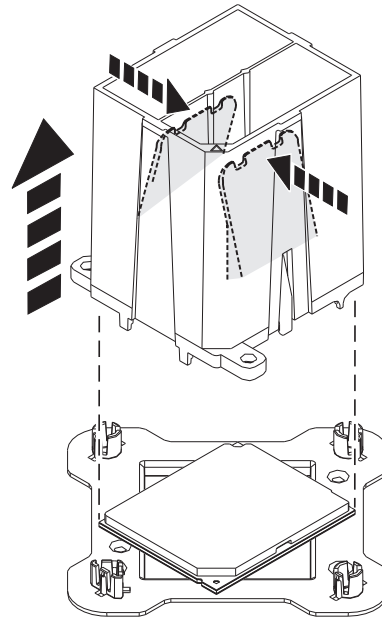


Figure 27. Blocage du module processeur système dans l'outil



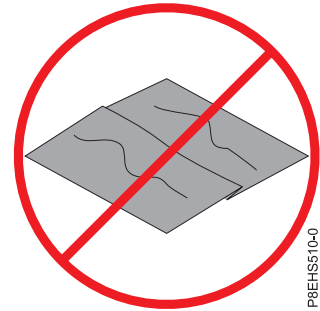
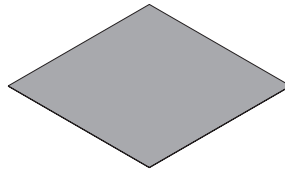
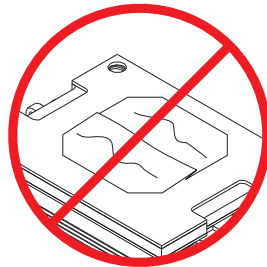
P8EDE521-1

Figure 28. Positionnement de l'outil en biais sur le couvercle de l'emballage
Si le matériau d'interface thermique est endommagé, remplacez-le.



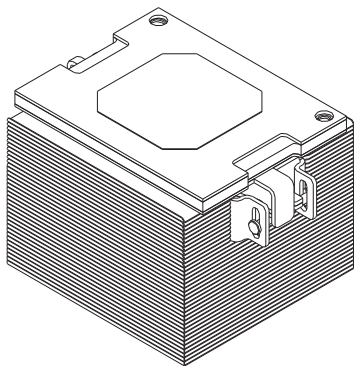
P8EDE522-1

Figure 29. Dégagement du module processeur système de l'outil



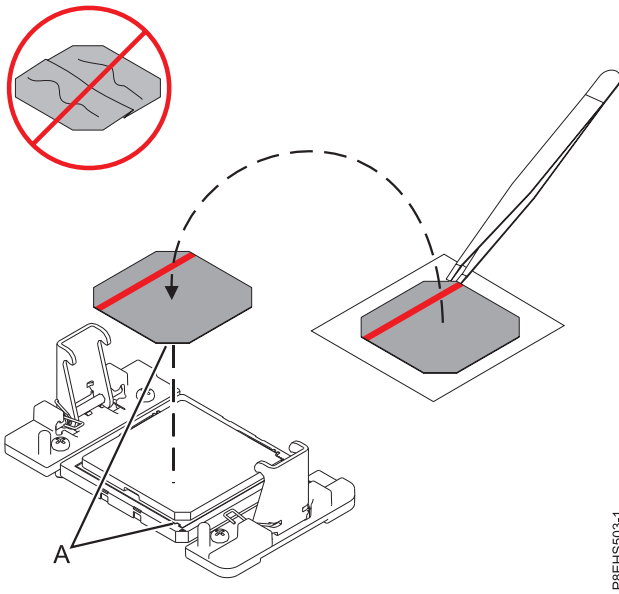
P8EHS510-0

Figure 31. Inspection du matériau d'interface thermique gris



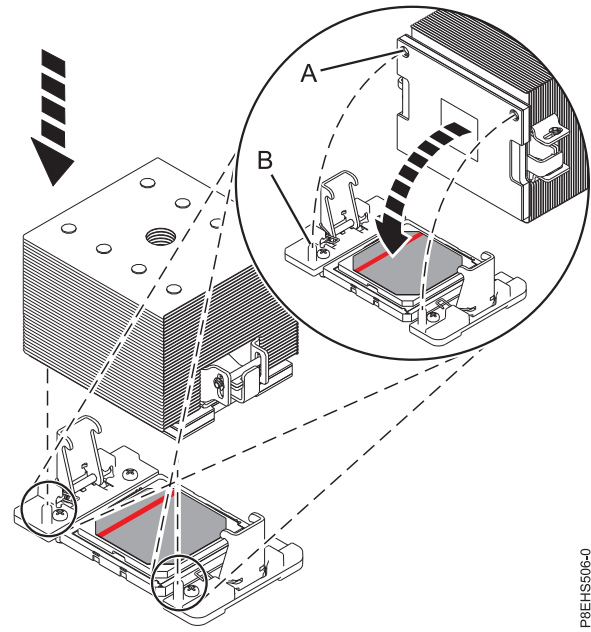
P8EHS502-0

Figure 30. Inspection du matériau d'interface thermique argenté



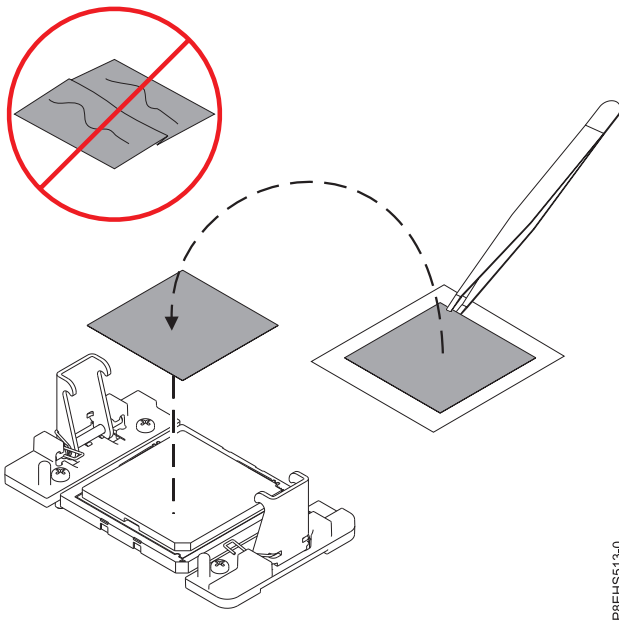
P8EHS503-1

Figure 32. Installation du matériau d'interface thermique argenté sur le processeur



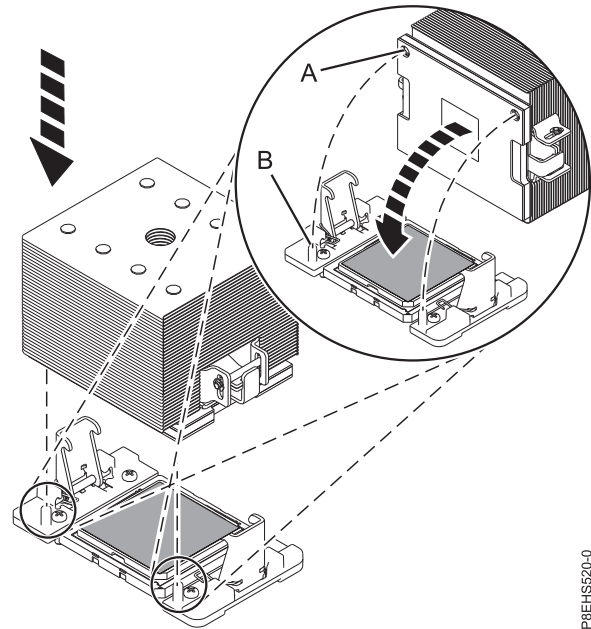
P8EHS506-0

Figure 33. Installation du dissipateur thermique neuf sur le matériau d'interface thermique argenté



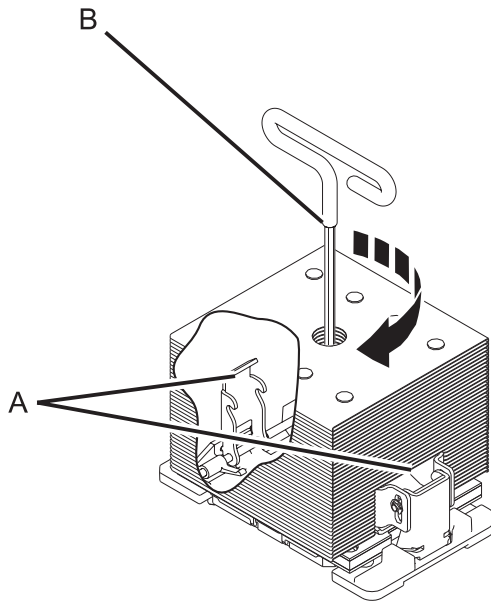
P8EHS513-0

Figure 34. Installation d'un matériau d'interface thermique gris neuf sur le processeur



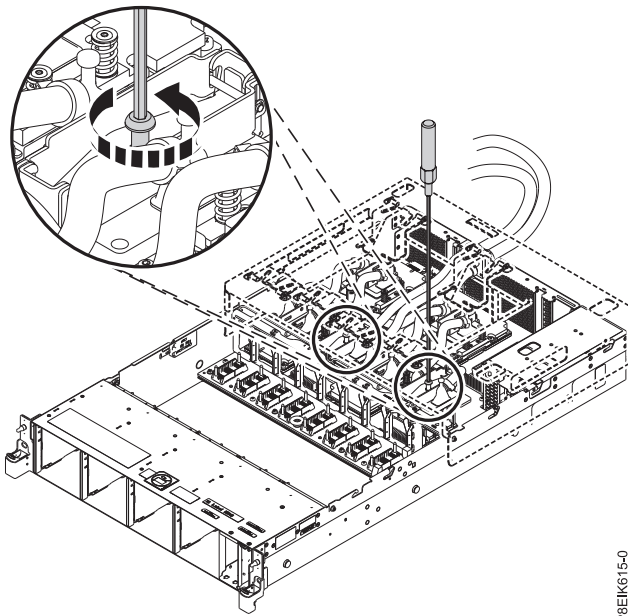
P8EHS520-0

Figure 35. Installation du dissipateur thermique sur le matériau d'interface thermique gris



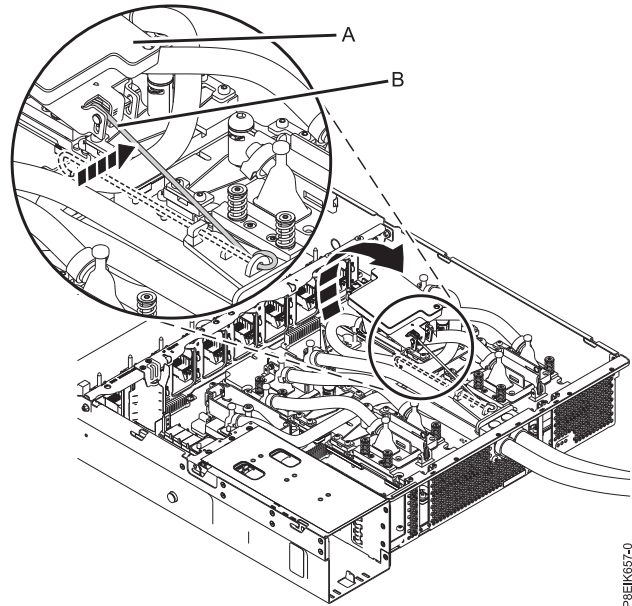
P8EHS507-0

Figure 36. Serrage de la vis de pression centrale sur le dissipateur thermique



P8EIK615-0

Figure 37. Desserrage de la vis de maintien de la plaque froide



P8EIK657-0

Figure 38. Retrait de la plaque froide

Cette édition du 20 juillet 2017 s'applique aux serveurs IBM Power Systems dotés du processeur POWER8 et à tous les modèles associés.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2017. Tous droits réservés.

© Copyright IBM Corporation 2016, 2017.